

美商Diodes和敦南科技結合，產線互補發揮綜效!

半導體產業相互整合，提升產能利用率、增加營運效率並降低生產成本，公平會不予禁止。

■撰文=方彥修
(公平會製造業競爭處科員)

前言

敦南科技股份有限公司(下稱敦南科技)原持有美商 Diodes Incorporated (下稱Diodes) 股份，為提升營運及行政上之綜效，以及敦南科技之設備利用率，Diodes擬透過台灣達爾科技股份有限公司取得敦南科技之股份，符合公平交易法第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且參與結合事業上一會計年度之銷售金額達公平交易法第11條第1項第3款規定之申報門檻，又無同法第12條規定除外適用情形，依法向公平會提出結合申報。

相關市場

參與結合事業皆為全球半導體供應商，Diodes主要產品分別為整流二極體、功率管理IC、功率電晶體和小信號電晶體；敦南科技主要產品及服務則分別為整流二極體、接觸式影像感測器、封測代工、晶圓代工和功率管理IC。本案參與結合事業之重疊性產品均為各類型半導體，計有功率電晶體、整流二極體、放大器和比較器、功率管理IC、晶圓代工與封裝測試等6項產品和服務，具有水平競爭關係，雖該等產品均銷售於全球，但以結合後是否對我國境內相關市場產生反競爭影響為關注重點。

競爭評估

本結合經進一步檢視重疊性產品市場競爭狀況，結合後市占率增加有限，無顯著的單方效果；又競爭廠商多，參與結合事業所屬之產業並無特殊之參進障礙，在我國之交易相對人為大型電子廠及代理商，具相當抗衡力量。另參與結合事業之規模不及國際大廠，未來參與結合雙方產品線且可互補，有助敦南科技快速提升現有晶圓廠的產能利用率，對整體經濟應有所助益。

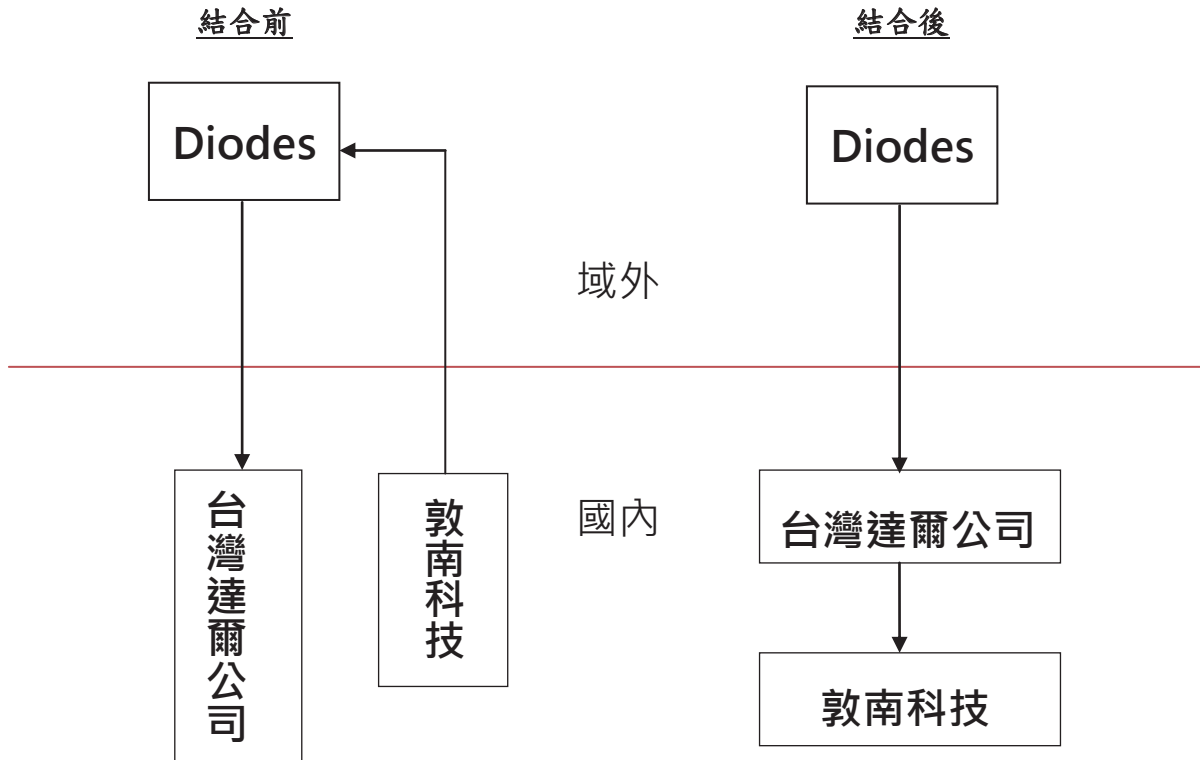
敦南科技目前於全球提供晶圓代工服務，Diodes於全球產能不足時方委由敦南科技提供少量代工服務，再由Diodes進行封測後銷售。但Diodes未於我國提供晶圓代工及封測服務，故垂直交易關係僅發生在國外，結合後不致影響我國晶圓代工及封測服務市場之結構與競爭狀態，亦無相關造成市場封鎖效果之因素，並無顯著限制競爭之疑慮。

結論

經公平會函詢產業目的事業主管機關、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見綜合研判，認為本結合實施後不具有顯著限制競爭疑慮，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。



結合前後組織變化圖



(圖片來源：公平會依照事業結合申報書重製)